2009 (2) مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم الأساسية المجلد (31) العدد (2) Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Basic Sciences Series Vol. (31) No. (2) 2009

دراسة شبه تجريبية لمدى توزع أيونات B,AI,P,As المزروعة في السيلكون الأمورفي

الدكتور بدر الأعرج^{*} الدكتور مفيد عباس ^{**}

(تاريخ الإيداع 29 / 4 / 2009. قُبِل للنشر في 22/10/2009)

🗆 الملخّص 🗆

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد R مدى توزع أيونات B,Al,P,As المسرّعة بطاقات في المجال 300 – 50 لمحرروعة في هدف سيليكوني باستخدام طريقة شبه تجريبية لاشابته بحاملات شحنة من النوع n و q ثم حساب keV المزروعة في هدف سيليكوني باستخدام طريقة شبه تجريبية لاشابته بحاملات شحنة من النوع n و q ثم حساب مقدار التشتت AR_p عن مسقط مسار الأيون R_p على امتداد الحزمة الأيونية الواردة، وذلك بافتراض أن وسيط التصادم يأخذ قيماً مختلفة من نصف قطر بور الذري. لقد تم حساب R باستخدام التكامل العددي وذلك بكتابة برنامج المعادم يأخذ قيماً مختلفة من نصف قطر بور الذري. لقد تم حساب R باستخدام التكامل العددي وذلك بكتابة برنامج في Matlab

ولوحظ من الدراسة أن مدى توزع الأيونات المزروعة يزداد تدريجياً بزيادة طاقة الأيون المزروع وزيادة وسيط التصادم في المجال Å 0.055 – 0.053 .

الكلمات المفتاحية: زرع الأيونات- مسقط مسار الأيون- مدى مسار الأيون- وسيط التصادم- طاقة الحزمة الأيونية-مقطع الكبح الالكتروني - مقطع الكبح النووي.

^{*} أستاذ – قسم الفيزياء – كلية العلوم – جامعة تشرين – اللاذقية – سورية.

^{**} أستاذ – قسم الفيزياء – كلية العلوم – جامعة تشرين – اللاذقية – سورية.

2009 (2) مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم الأساسية المجلد (31) العدد (2) Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Basic Sciences Series Vol. (31) No. (2) 2009

Semi-Empirical Study of Range Distribution of Implanted Ions B, Al, P, As in Amorphous Silicon Target

Dr. Badr Al- Aaraj * Dr. Mufid Abbas **

(Received 29 / 4 / 2009. Accepted 22/10/2009)

\Box ABSTRACT \Box

This paper aims to calculate the distribution range R of implanted ions B ,Al ,P ,As in silicon target which accelerated to energies ranged between 50 – 300 keV using semiempirical method in order to dope the Si –semiconductor with n and p type of charge carriers. In addition, we calculate the scattering parameter (standard deviation) ΔR_p from the projected range R_p .

For calculating R we used the numerical integration by writing a Matlab program in suggesting that the impact parameter p takes different values of Bohr radius.

It is shown that the range distribution of implanted ions increases gradually by rising the ion beam energy and also by crowing the impact parameter in the interval 0.053 - 0.80Å.

Keywords: ion implantation, projected range, ion path range, impact parameter, ion beam energy, electronic cross- section, nuclear cross-section

^{*} Professor, Physics Department , Faculty of Science , Tishreen University, Lattakia , Syria.

^{**} Professor, Physics Department, Faculty of Science, Tishreen University, Lattakia, Syria.

مقدمة:

جاءت إشابة أنصاف النواقل بتقانة الزرع الأيوني بعد طريقة الأشابة بطريقة الانتشار التقليدية. وتعد طريقة زرع الأيونات طريقة متطورة ومرنة لإشابة بلورات الجسم الصلب، وتتم عملية الزرع كما يلي: تدخل الأيونات المسرعة إلى بلورة الجسم الصلب وتصطدم مع ذراتها ثم تفقد طاقتها الحركية تدريجيا إلى أن تصل بالنهاية إلى حالة السكون داخل البلورة.

يتوقف عمق توغل الحزمة الساقطة على البلورة على عدة عوامل منها: نوع ذرة الإشابة، مادة الهدف، الطاقة الأولية للحزمة، درجة الحرارة، الجرعة الأيونية ، ودرجة التخلية . يبين الشكل 1 مسار الأيون داخل الهدف والرموز المتعلقة به.



الشكل 1 :يوضح الرموز الآنية: R مسار الأيون المزروع داخل الهدف. R_p مسقط المسار على امتداد اتجاه الأيون الوارد على سطح الهدف. R_L المسافة بين نقطة دخول الأيون وموضع استقرار ه. R_c عمق التوغل.

تعالج الأسس النظرية لزرع الأيونات في الأجسام الصلبة، توزع أعماق توغل الأيونات المزروعة، و فقد طاقتها بفعل عمليات الفرملة، وتوزع التشوهات والعيوب الناتجة عن عمليات الزرع في البلورة، ثم دراسة سلوك توغل الأيونات في الأجسام الصلبة الأمورفية (الرزع العشوائي)، والأجسام الصلبة وحيدة التبلور ومتعددة التبلور (الزرع المقناة) [18,17,16,1].

> يمكننا تصنيف المفاعيل الناتجة عن عملية قذف الأيونات في الجسم الصلب كما يلي: 1.تصادمات مرنة وغير مرنة مع الالكترونات الحرة والمقيدة لذرات الهدف. 2.تصادمات مرنة وغير مرنة مع نوى ذرات الهدف.

وتوجد آليتين رئيسيتين لفقد الطاقة بوحدة المسار أثناء تفاعل الأيونات المقذوفة مع ذرات الهدف.

 الكبح الإلكتروني: فقد الطاقة بالتصادمات غير المرنة مع الالكترونات المقيدة. لقد درست هذه العملية من قبل Lindhard و Winter وبيّنا أن مقطع الكبح الالكتروني Se(E) يتناسب مع سرعة الأيونات المقذوفة ، وبالتالي مع الجذر التربيعي لطاقة الحزمة الأيونية في مجال الطاقات المألوفة [5,4,3,2].

$$\frac{dE}{dx} \propto \mathbf{S}_{e}(E) = kE^{1/2} \tag{1}$$

ولإيجاد فقد الطاقة بالكبح الالكتروني قدّم Firsov نموذجا يفترض أن الأيون الصادم وذرة الهدف يشكلان معاً شبه جزيئه . ويحصل أثناء عملية التصادم تبادل بين الكترونات شبه الجزيئة مما يؤدي إلى انتقال جزء من الطاقة الحركية للأيونات إلى ذرة الهدف وبالتالي كبح الأيون [4,3].

$$\Delta E_e(E,p) = \int_0^\infty T_e(E,p) \cdot d\sigma_e = \frac{35 \times 10^{-2} (Z_1 + Z_2)^{5/3} \hbar \sqrt{\frac{2}{M_1}} \sqrt{E}}{a_0 (1 + 16 \times 10^{-2} (Z_1 + Z_2)^{1/3} \cdot \frac{p}{a_0})^5}$$
(2)

في هذه العلاقة تقدر الطاقة بـ keV والأبعاد بـ Å والكتل بوحدة الكتل الذرية amu.

حيث $a_0=0.53$ نصف قطر p، Bohr وسيط التصادم ويعبّر عن أقرب مسافة فاصلة يصلها الجسمين $a_0=0.53$ المتصادمين، $T_{\rm e} \cdot b = 2\pi p dp$ ، $\hbar = 0.659 \times 10^{-18} keV \cdot sec$ المتصادمين، الالكتروني، Te الطاقة الحركية المنتقلة بفعل التصادم مع الالكترونات المقيدة.

يبين الجدول 1 بعض الوسيطات الخاصة بالأيون المسرع وذرة الهدف.

| الوسيط | الأيون الصادم | ذرة الهدف |
|---------------|----------------|----------------|
| العدد الذري | Z_1 | Z_2 |
| الكتلة الذرية | M ₁ | M ₂ |
| السرعة | V ₁ | _ |

الجدول 1 : بعض الرموزالخاصة بالأيون المسرع وذرة الهدف.

• الكبح النووي: يتناسب فقدان الطاقة بالتصادمات المرنة مع نوى ذرات الهدف ومع مقطع الكبح النووي $\frac{dE}{dr} \propto S_n(E)$

$$\Delta E_n = \int_0^\infty T_n \cdot d\sigma_n = T_{\max} \cdot \cos^2 \left(\frac{\pi p}{2 \left[p^2 + a^2 \frac{V_s}{E_{cm}} \right]^{1/2}} \right)$$
(3)

حيث:
حيث:

$$V_s = \frac{Z_1 Z_2 e^2 a}{d^2}$$

 $V_s = \frac{Z_1 Z_2 e^2 a}{d^2}$
الأيون وذرة الهدف . وعندما d=a نحصل على كمون الحجب [7,6].
 $I_{reac} = d M_1 M_2 = \frac{2}{(M_1 + M_2)^2} E$
 $I_{reac} = \frac{4M_1 M_2}{(M_1 + M_2)^2} E$
 $I_{reac} = \frac{M_2}{(M_1 + M_2)} E$
 $E_{cm} = \frac{M_2}{(M_1 + M_2)} E$
 $e^2 = e_0^2 / 4\pi\varepsilon_0 = 1.44 \times 10^{-2} keV.$
 A
 $a = \frac{1}{2} (\frac{3}{4} \pi)^{2/3} a_0 (Z_1^{1/2} + Z_2^{1/2})^{-2/3}$
 $e_1 = \frac{1}{2} (\frac{3}{4} \pi)^{2/3} a_0 (Z_1^{1/2} + Z_2^{1/2})^{-2/3}$

$$\frac{dE}{dx} = NS_e + NS_n \tag{4}$$

$$R(p, E_0) = \int_0^{E_0} \frac{dE}{\Delta E_e + \Delta E_n}$$
(5)

أهمية البحث وأهدافه:

نتجلى أهمية هذا البحث في التحديد المسبق لعمق توزع الأيونات المزروعة عن طريق التحكم بالشروط الإبتدائية لطاقة الزرع للحصول على عينات نصف ناقلة من السيليكون بخصائص ومواصفات جديدة، ثم إيجاد قيم وسيط التصادم المناسبة لمجال طاقات التسريع بطريقة شبه تجريبية.

طرائق البحث ومواده:

لقد تم حساب عمق التوغل R بالتكامل العددي للعلاقة (5) وذلك بكتابة برنامج في Matlab . ولحساب التكامل العددي افترضنا أن وسيط التصادم يأخذ القيم :

p= 10%, 25%, 50%, 100%, 150% من نصف قطر بور الذري. علاوة على ذلك، أخذنا قيم طاقات التسريع للأيونات في المجال 80 – 50 .

النتائج والمناقشة:

0.76 - 1.01 أشارت النتائج التجريبية لوسيط التصادم للأيونات $26 \ge Z_1 \ge 26$ أنه يأخذ قيماً في المجال 0.76 - 0.76 [10,9] . وهذا ما دعانا إلى دراسة تأثير وسيط التصادم على عمق توزع الأيونات المزروعة، وذلك بافتراض أن وسيط التصادم يأخذ قيما نسبية من نصف قطر بور ، وذلك لدراسة سلوك الأيونات $25 \ge Z_1 \ge 25$ المسرعة في المجال الطاقى 200 = 0.5 .

يبين الشكل 2 الرسم البياني لقيم تجريبية مأخوذة من المرجع [1] لمقارنتها مع قيمنا المحسوبة بطريقة شبه تجريبية.

يحتوي الجدول 2 على نتائج التكامل العددي لأيون البور .

| الجدول 2 : يتضمن القيم المحسوبة بالتكامل العددي لأيون البور. | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|
| E/keV | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | | | |
| R _p /µm | 0.5786 | 1.9635 | 3.8721 | 6.1246 | 8.6060 | 11.2399 | | | |
| $\Delta R_p / \mu m$ | 0.9130 | 3.0761 | 5.9557 | 9.2423 | 12.7483 | 16.3586 | | | |



الشكل 2 : يبين عمق توزع أيونات B ,P ,As بتابعية طاقتها في Si . القيم مأخوذة من [1] .

نلاحظ من الشكل أن أيون البور يتوغل بشكل بارز مقارنة مع أيون الفوسفور والزرنيخ. ونعزو ذلك إلى أن نصف قطر ذرة البور أصغر (انظر الجدول 3) . لذا يمكنه التوغل إلى الفراغات والاستقرار داخل الهدف بعد فقد طاقته، ومن جهة أخرى، يتناسب عمق التوغل عكساً مع مقطع الفرملة والذي بدوره يتناسب طرداً مع العدد الذري للأيون الصادم، وبالتالي يكون مقطع الفرملة، عند الزرنيخ أعلى منه عند البور ، ويتحقق عكس ذلك بالنسبة إلى عمق التوغل [13].

يحتوي الجدول 3 على نصف القطر الذري والكثافة الذرية للعناصر المدروسة.

| | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | - <u>-</u> | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Element | Si | В | Al | Р | As |
| r _a /Å | 1.17 | 0.088 | 1.26 | 1.10 | 1.21 |
| N/cm ³ | 1.30×10^{23} | 6.02×10^{22} | _ | 4.05×10^{22} | 5.00×10 ²² |

الجدول 3 : يحتوى على نصف القطر الذرى والكثافة الذرية.

توضح الأشكال (a – e) الدور البارز لأيون البور في توغله داخل الهدف السيلكوني . ونلاحظ من الشكل (p=0.053Å توضح الأشكال (a – e) أن عمق توغل أيونات الألمنيوم والفسفور والزرنيخ شبه مستقل عن وسيط التصادم عند القيمة (a - a) = 0.053 وأشير في [15,14] إلى أن عمق التوغل (110) Si(110)

ويمكننا أخذ فكرة عن حساب تقريبي لوسيط التصادم من العلاقة الآتية [5] .

$$p = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2 d}{E}\right)^{1/2}$$
$$d(Si) = \left(\frac{6}{\pi N_{Si}}\right)^{1/3} = 2.45 \text{ Å}^{0}$$



الشكل B, Al, P, As يبين تابعية مدى توزع أيونات B, Al, P, As لطاقتها عند وسيط تصادم p= 0.053Å.



الشكل B,Al,P,As : يبين تابعية مدى توزع أيونات B,Al,P,As لطاقتها عند وسيط تصادم p=0.265Å.



الشكل B,AI,P,As : يبين تابعية مدى توزع أيونات B,AI,P,As لطاقتها عند وسيط تصادم p=0.397Å.





الشكل B,Al,P,As : يبين تابعية مدى توزع أيونات B,Al,P,As لطاقتها عند وسيط تصادم p=0.795Å.



الشكل 4 : يظهر تابعية مدى أيون البور المزروع لوسيط التصادم عند طاقات مختلفة.

ونلاحظ من الشكل 4 وجود مجالين .

ا**لمجال الأول:** يمتد من A و 0.3 م p = 0.05 – 0.3 Å ويوجد تطابق بين سلوك الأيونات مع اختلاف طاقتها ويناسب هذا المجال من وسيط التصادم طاقات التسريع المقترحة ، وبصورة خاصة يوجد شبه تتطابق بين قيمنا المحسوبة عند القيمة p = 0.265 Å والقيم التجريبية التي لم يذكر عندها قيمة وسيط التصادم.

المجال الثاني: يمتد من p = 0.3 – 0.8 Å . وفي هذا المجال نلاحظ فرز فعالية طاقة التسريع مع وسيط التصادم. ولكن قيم مدى توزع الأيونات في هذا المجال كبيرة نسبيا، بالمقارنة مع القيم التجريبية، مما يؤكد أن المجال الأول هو المناسب لطاقات التسريع المقترحة.

الاستنتاجات والتوصيات:

استناداً إلى نموذج Firsov يمكننا أخذ صورة تقريبية عن توزع الأيونات المسرعة في السيليكون بعد معرفة وسيط التصادم.

وينقسم المخطط البياني لعمق التوغل بتابعية وسيط التصادم إلى مجالين .

ا**لمجال الأول**: يمتد من Å 0.3 – 0.05 – p حيث وسيط التصادم هذا يناسب طاقات التسريع المقترحة. وعند القيمة Å p = 0.265 Å يوجد شبه تتطابق بين القيم المحسوبة والقيم التجريبية.

المجال الثاني: يمتد من p = 0.3 - 0.8 ويبين التأثير الواضح لوسيط التصادم على عمق التوغل.

amu: atomic mass unit

Matlab: Matrix Laboratory RBS: Rutherford Backscattering SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry

المراجع:

- [1] YSSEL,H.R; RUGE ,I. *Ionenimplantation*, Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1978, 10.
- [2] LINDHARD, WINTER, J. A. 1964-Kgl. Danske Videnskab.Selskab.Mat.-Fys.Medd., No.4, 1959,34.
- [3] FIRSOV ,O.B. Zh. Eksp, Teor. Fiz., V.. 36, No.3, 1959, 1517.
- [4] FIRSOV, O.B. 1958-Zh.Eksp.Teor.Fiz., V. 34, No.2, 1958, 447.
- [5] ABBAS ,M. et al. *Heavy Ion Channeling Implantation Processes in Crystals*, phys.stst.sol.(b),1990, 159.
- [6] FIRMI, E. Z. Phys, V.48, 1928, 73.
- [7] MAYER, MARC, J. W.; NICOLET, A. *Backscattering Spectrometry*, Academic Press ,New York, San Francisco, London, 1978, 150.
- [8] MANFRED von ARDENNE, GERHARD MUSIOL, SIEGFRIED REBALL. *Effekte der Physik*, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1989, 200.
- [9] WILSON, R.G. J. Appl. Phys. 61, 8, 1987, 2734 2736.
- [10] EISEN,F.H. *channeling of medium ions through silicon*, Science Center of North American Rockwell Corporation ,Calif.,USA,1967, 9
- [11] REINER WEDEL. *Reichweiten und Sputtering bei niedrigen Energien*, Wiss. Zeitschrift der Humboldt Universitaet, Berlin, 1985, 158.
- [12] MICHAEL GRIEPENTROG und RALF KOECHERT, Ionenstrahlverfahren zur Veraenderung von Festkoeperoberflaechen, Wiss. Zeitschrift der Humboldt Universitaet, Berlin, 1988, 269.
- [13] XIANGDONG LIU, PIJUN LIU, FENG CHEN, MINGWEN ZHAO, YUCHEN MA, MINJU, JIANHUA ZHANG, QINGMING LU, CHUNSHENG WANG. *Electronic* stopping powers for fluorine ions in F-implanted tin-oxide films prepared by APCVD, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 187,2002, 431– 436.
- [14] HIDETOSHI KIMURA WATARU TAKEUCHI. *New local model for electronic energy loss and its application to computer simulations of channeling*, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266, 2008, 224–228.
- [15] BIANCONI , M.; ARGIOLAS,N.; BAZZAN,M. ; BENTENI,G.; CHIARNI, CERUTTI, G. M. ; A. ; MAZZOLDI,P.; PENNESTRI, SADA G. Nuclear and electronic energy loss synergy in the process of damage growth in ion implanted LiNbO3, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 249, 2006, 122– 125.

- [16] مفيد عباس. ميز*ات زرع الأيونات الثقيلة باتجاه القنوات* ، المجلد (16) 'العدد (3)، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،1994
- [17]مفيد عباس ،محمد فاهود. دراسة نظرية لحركة الأيونات المزروعة في الاتجاه المحوري لعينة هدف كريستالية ، المجلد (19) 'العدد (6)، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،1997
- [18] يحيى سليمان 'د. محمود أحمد ، د.مفيد عباس. زرع الأيونات في الأجسام الصلبة ،المجلد (14) 'العدد
 (1)، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،1992